

プログラム可能な薄膜成膜用Plc制御ディップコーティング装置

商品番号: TB13



前書き

速度1~200

mm/min、浸漬・乾燥・サイクルのプログラム設定、コンパクト設計、CE認証を備えたPLC制御ディップコーティング装置。精密な研究用薄膜成長を実現し、研究・産業用途で信頼性と再現性の高いプロセス制御および簡単な操作を提供します。恒温乾燥機もオプションで選択できます

[詳細を学ぶ](#)

用途	説明	主な利点
ソルゲル薄膜研究	プログラムされた動作と保持時間により、液相ソルゲルコーティング材料中へ試料を垂直に浸漬・引き上げます。	配合比較やプロセス研究において、再現性のある成膜条件を提供します。
電池・先進材料研究	機能性材料や表面層の研究に使用される試料基板上で、制御されたコーティング実験を行います。	小規模な研究ワークフローにおいて、コーティングと乾燥のシーケンスをプログラムできます。
光学・機能性表面の開発	表面特性、膜厚、機能層に関する探索的研究向けに、適切なサイズの試料へ液相薄膜を形成します。	引き上げ速度、浸漬時間、サイクル回数を体系的に変更できます。
セラミック・材料科学研究室	セラミックコーティング、材料界面、液相による膜形成の研究において、試料片を処理します。	コンパクトな研究室用プラットフォームで、制御された垂直動作を提供します。
大学の教育研究室	ディップコーティング、浸漬時間、引き上げ挙動、膜成長を実演するための扱いやすい方法を提供します。	シンプルなタッチスクリーン操作により、学生や初心者でも設定された手順を実行できます。
研究機関のプロセス開発	液体材料、基板、プロセスパラメータを研究室規模で比較するため、再現性のあるコーティングプログラムを実行します。	実験バッチ間の手動操作によるばらつきを低減します。
産業用研究室試験	企業の研究室や品質管理研究室において、小試料のコーティング試験と予備的なプロセス評価をサポートします。	大型の生産規模システムを必要とせず、プログラム運転を実現します。

仕様カテゴリー	パラメータ	値
製品識別情報	製品名	TB13 PLC制御プログラム式ディップコーティング装置
設置条件	最大使用高度	1000 m未満
設置条件	周囲温度	25°C ± 15°C
設置条件	相対湿度	55% Rh ± 10% Rh
ユーティリティ	給水	不要
ユーティリティ	電源	AC 220 V、50 Hz
ユーティリティ	接地	良好な接地が必要

仕様カテゴリー	パラメータ	値
ユーティリティ	ガス供給	不要
ユーティリティ	換気設備	不要
作業台要件	推奨作業台寸法	800 mm x 600 mm x 700 mm
作業台要件	作業台の最小耐荷重	200 kg超
電気仕様	定格電圧	220 V
電気仕様	電力	50 W
動作制御	引き上げ速度	1 mm/min-200 mm/min
コーティングプロセス	有効浸漬長さ	60 mm
時間制御	浸漬時間設定	1-999 s
時間制御	乾燥時間設定	1-999 s
サイクル制御	昇降サイクル数	1-20サイクル
負荷容量	昇降荷重	≤100 g
試料適合性	試料寸法	75 mm x 25 mm x 2.5 mm
外形寸法	装置寸法	320 mm x 260 mm x 560 mm
外形寸法	重量	17 kg
インターフェース・適合規格	操作インターフェース	カラータッチスクリーン
インターフェース・適合規格	認証	CE認証取得
オプション構成	恒温乾燥	必要に応じて恒温乾燥炉をオプションで利用可能